

## ANEXO I

### LISTADO DE ITEM NCM SA 2002 SUJETOS A REQUISITOS ESPECIFICOS DE ORIGEN Los item arancelarios que no se encuentren listados en el presente Anexo, estarán sujetos a las disposiciones previstas en el Artículo 3 literales a) a f)

Ítem N.C.M.	Identificación del Requisito de Origen / Identificação do Requisito de Origem
0401.10.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
0401.10.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
0401.20.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
0401.20.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
0401.30.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
0402.10.10	Deberán ser elaborados a partir de leche producida en los Estados Partes.
0402.10.90	Deberán ser elaborados a partir de leche producida en los Estados Partes.
0402.21.10	Deberán ser elaborados a partir de leche producida en los Estados Partes.
0402.21.20	Deberán ser elaborados a partir de leche producida en los Estados Partes.
0402.29.10	Deberán ser elaborados a partir de leche producida en los Estados Partes.
0402.29.20	Deberán ser elaborados a partir de leche producida en los Estados Partes.
0405.10.00	Deberán ser elaborados a partir de leche producida en los Estados Partes.
0408.11.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
0408.91.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1302.13.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1507.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1507.90.11	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1507.90.19	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1508.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1508.90.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1511.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1511.90.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1512.11.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1512.19.11	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1512.19.19	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1512.21.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1512.29.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1513.11.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1513.21.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1513.29.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1515.29.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1515.29.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1515.90.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1516.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1516.20.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1517.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1517.90.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1517.90.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1601.00.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1602.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1602.20.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1602.50.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1702.11.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1702.40.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1803.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1803.20.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1804.00.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
1805.00.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2002.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2002.90.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2004.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2004.90.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2005.20.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2005.40.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2005.90.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional

2006.00.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2007.91.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2007.99.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2007.99.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2008.70.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2008.70.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2101.11.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2102.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2102.20.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2106.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2106.90.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2204.10.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2204.21.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2204.29.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2207.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2207.20.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2208.30.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2208.30.20	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2208.60.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2208.70.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2309.90.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2309.90.90 (1)	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2523.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2523.29.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2523.29.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
Capítulo 28	Deberán cumplir con el requisito de origen establecido en el artículo 3º del Régimen de Origen Mercosur y obtenerse mediante un proceso productivo que implique una modificación molecular resultante de una sustancial transformación y que cree una nueva identidad química.
Capítulo 29	Deberán cumplir con el requisito de origen establecido en el artículo 3º del Régimen de Origen Mercosur y obtenerse mediante un proceso productivo que implique una modificación molecular resultante de una sustancial transformación y que cree una nueva identidad química.
3808.10.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.10.21	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.10.22	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.10.23	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.10.24	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.10.25	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.10.26	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.10.27	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.20.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.20.21	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.20.22	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.20.23	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.20.24	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.20.25	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.30.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.30.21	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.30.22	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.30.23	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.30.24	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.30.25	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3808.90.21	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3904.10.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3904.10.20	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
3904.10.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional

(1) Excepto el producto definido como “premezclas que contengan vitaminas con soporte de sustancias orgánicas nutritivas y/o de sustancias inorgánicas específicamente elaboradas para ser agregadas a la ración animal completa “ de acuerdo a los términos de la Directiva CCM N° 02/04.



















6006.33.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
6006.34.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
6006.41.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
6006.42.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
6006.43.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
6006.44.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
6006.90.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
6105.20.00	60% de valor agregado regional
6106.90.00	60% de valor agregado regional
6107.19.00	60% de valor agregado regional
6109.90.00	60% de valor agregado regional
6112.12.00	60% de valor agregado regional
6115.93.00	60% de valor agregado regional
6203.11.00	60% de valor agregado regional
6203.43.00	60% de valor agregado regional
6204.43.00	60% de valor agregado regional
6205.10.00	60% de valor agregado regional
6205.20.00	60% de valor agregado regional
6205.30.00	60% de valor agregado regional
6206.40.00	60% de valor agregado regional
6211.11.00	60% de valor agregado regional
6402.19.00	60% de valor agregado regional
6402.20.00	60% de valor agregado regional
6402.91.00	60% de valor agregado regional
6402.99.00	60% de valor agregado regional
6403.51.00	60% de valor agregado regional
6403.59.00	60% de valor agregado regional
6403.91.00	60% de valor agregado regional
6403.99.00	60% de valor agregado regional
6404.11.00	60% de valor agregado regional
6404.19.00	60% de valor agregado regional
7017.90.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
7208.10.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7208.25.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7208.26.10	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7208.26.90	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7208.27.10	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7208.27.90	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7208.36.10	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7208.36.90	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7208.37.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7208.38.10	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7208.38.90	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7208.39.10	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7208.39.90	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes
7208.40.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la partida 7206 o 7207, fundidos y moldeados o







7304.39.90	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7304.49.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7304.51.10	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7304.51.90	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7304.59.10	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7304.59.90	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7304.90.11	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7304.90.19	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7304.90.90	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7305.11.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7305.12.00 (2)	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7305.19.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7305.20.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7305.31.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7305.39.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7305.90.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7306.10.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7306.20.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7306.30.00 (3)	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7306.50.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7306.60.00	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7306.90.10	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7306.90.90	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7308.10.00	60% de valor agregado regional
7308.20.00	60% de valor agregado regional
7309.00.10	60% de valor agregado regional
7309.00.90	60% de valor agregado regional
7310.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
7310.21.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
7310.21.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
7310.29.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
7310.29.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
7311.00.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
7321.11.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional

(2) Excepto "Tubos para caños elaborados con soldadura continua por resistencia eléctrica, de diámetro superior a 590 mm e inferior a 630 mm."

(3) Excepto "Tubos de acero aluminizado".

7321.81.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
7326.90.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
8207.30.00	60% de valor agregado regional
8301.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
8401.10.00	60% de valor agregado regional
8401.20.00	60% de valor agregado regional
8401.40.00	60% de valor agregado regional
8402.11.00	60% de valor agregado regional
8402.12.00	60% de valor agregado regional
8402.19.00	60% de valor agregado regional
8402.20.00	60% de valor agregado regional
8402.90.00	60% de valor agregado regional
8403.10.90	60% de valor agregado regional
8403.90.00	60% de valor agregado regional
8404.10.10	60% de valor agregado regional
8404.10.20	60% de valor agregado regional
8404.20.00	60% de valor agregado regional
8404.90.10	60% de valor agregado regional
8404.90.90	60% de valor agregado regional
8405.10.00	60% de valor agregado regional
8405.90.00	60% de valor agregado regional
8406.10.00	60% de valor agregado regional
8406.81.00	60% de valor agregado regional
8406.82.00	60% de valor agregado regional
8406.90.00	60% de valor agregado regional
8407.10.00	60% de valor agregado regional
8407.21.10	60% de valor agregado regional
8407.21.90	60% de valor agregado regional
8407.29.10	60% de valor agregado regional
8407.29.90	60% de valor agregado regional
8407.90.00	60% de valor agregado regional
8408.10.10	60% de valor agregado regional
8408.10.90	60% de valor agregado regional
8408.90.10	60% de valor agregado regional
8408.90.90	60% de valor agregado regional
8409.10.00	60% de valor agregado regional
8410.11.00	60% de valor agregado regional
8410.12.00	60% de valor agregado regional
8410.13.00	60% de valor agregado regional
8410.90.00	60% de valor agregado regional
8411.11.00	60% de valor agregado regional
8411.12.00	60% de valor agregado regional
8411.21.00	60% de valor agregado regional
8411.22.00	60% de valor agregado regional
8411.81.00	60% de valor agregado regional
8411.82.00	60% de valor agregado regional
8411.91.00	60% de valor agregado regional
8411.99.00	60% de valor agregado regional
8412.10.00	60% de valor agregado regional
8412.21.10	60% de valor agregado regional
8412.21.90	60% de valor agregado regional
8412.29.00	60% de valor agregado regional
8412.31.10	60% de valor agregado regional



8412.31.90	60% de valor agregado regional
8412.39.00	60% de valor agregado regional
8412.80.00	60% de valor agregado regional
8412.90.10	60% de valor agregado regional
8412.90.20	60% de valor agregado regional
8412.90.80	60% de valor agregado regional
8412.90.90	60% de valor agregado regional
8413.11.00	60% de valor agregado regional
8413.19.00	60% de valor agregado regional
8413.40.00	60% de valor agregado regional
8413.50.10	60% de valor agregado regional
8413.50.90	60% de valor agregado regional
8413.60.11	60% de valor agregado regional
8413.60.19	60% de valor agregado regional
8413.60.90	60% de valor agregado regional
8413.70.10	60% de valor agregado regional
8413.70.80	60% de valor agregado regional
8413.70.90	60% de valor agregado regional
8413.81.00	60% de valor agregado regional
8413.82.00	60% de valor agregado regional
8413.91.00	60% de valor agregado regional
8413.92.00	60% de valor agregado regional
8414.10.00	60% de valor agregado regional
8414.30.19	60% de valor agregado regional
8414.30.99	60% de valor agregado regional
8414.40.10	60% de valor agregado regional
8414.40.20	60% de valor agregado regional
8414.40.90	60% de valor agregado regional
8414.51.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
8414.59.10	60% de valor agregado regional
8414.59.90	60% de valor agregado regional
8414.80.11	60% de valor agregado regional
8414.80.12	60% de valor agregado regional
8414.80.13	60% de valor agregado regional
8414.80.19	60% de valor agregado regional
8414.80.21	60% de valor agregado regional
8414.80.22	60% de valor agregado regional
8414.80.29	60% de valor agregado regional
8414.80.31	60% de valor agregado regional
8414.80.32	60% de valor agregado regional
8414.80.33	60% de valor agregado regional
8414.80.39	60% de valor agregado regional
8414.80.90	60% de valor agregado regional
8414.90.10	60% de valor agregado regional
8414.90.31	60% de valor agregado regional
8414.90.32	60% de valor agregado regional
8414.90.33	60% de valor agregado regional
8414.90.34	60% de valor agregado regional
8414.90.39	60% de valor agregado regional
8415.10.90	60% de valor agregado regional
8415.20.90	60% de valor agregado regional
8415.81.90	60% de valor agregado regional
8415.82.90	60% de valor agregado regional
8415.83.00	60% de valor agregado regional

8415.90.00	60% de valor agregado regional
8416.10.00	60% de valor agregado regional
8416.20.10	60% de valor agregado regional
8416.20.90	60% de valor agregado regional
8416.30.00	60% de valor agregado regional
8416.90.00	60% de valor agregado regional
8417.10.10	60% de valor agregado regional
8417.10.20	60% de valor agregado regional
8417.10.90	60% de valor agregado regional
8417.20.00	60% de valor agregado regional
8417.80.10	60% de valor agregado regional
8417.80.20	60% de valor agregado regional
8417.80.90	60% de valor agregado regional
8417.90.00	60% de valor agregado regional
8418.50.10	60% de valor agregado regional
8418.50.90	60% de valor agregado regional
8418.61.90	60% de valor agregado regional
8418.69.10	60% de valor agregado regional
8418.69.20	60% de valor agregado regional
8418.69.90	60% de valor agregado regional
8418.99.00	60% de valor agregado regional
8419.20.00	60% de valor agregado regional
8419.31.00	60% de valor agregado regional
8419.32.00	60% de valor agregado regional
8419.39.00	60% de valor agregado regional
8419.40.10	60% de valor agregado regional
8419.40.20	60% de valor agregado regional
8419.40.90	60% de valor agregado regional
8419.50.10	60% de valor agregado regional
8419.50.21	60% de valor agregado regional
8419.50.22	60% de valor agregado regional
8419.50.29	60% de valor agregado regional
8419.50.90	60% de valor agregado regional
8419.60.00	60% de valor agregado regional
8419.81.10	60% de valor agregado regional
8419.81.90	60% de valor agregado regional
8419.89.10	60% de valor agregado regional
8419.89.20	60% de valor agregado regional
8419.89.30	60% de valor agregado regional
8419.89.40	60% de valor agregado regional
8419.89.91	60% de valor agregado regional
8419.89.99	60% de valor agregado regional
8419.90.20	60% de valor agregado regional
8419.90.31	60% de valor agregado regional
8419.90.39	60% de valor agregado regional
8419.90.40	60% de valor agregado regional
8419.90.90	60% de valor agregado regional
8420.10.10	60% de valor agregado regional
8420.10.90	60% de valor agregado regional
8420.91.00	60% de valor agregado regional
8420.99.00	60% de valor agregado regional
8421.11.10	60% de valor agregado regional
8421.11.90	60% de valor agregado regional
8421.12.90	60% de valor agregado regional

8421.19.10	60% de valor agregado regional
8421.19.90	60% de valor agregado regional
8421.21.00	60% de valor agregado regional
8421.22.00	60% de valor agregado regional
8421.29.11	60% de valor agregado regional
8421.29.19	60% de valor agregado regional
8421.29.20	60% de valor agregado regional
8421.29.30	60% de valor agregado regional
8421.29.90	60% de valor agregado regional
8421.39.10	60% de valor agregado regional
8421.39.30	60% de valor agregado regional
8421.39.90	60% de valor agregado regional
8421.91.91	60% de valor agregado regional
8421.91.99	60% de valor agregado regional
8421.99.10	60% de valor agregado regional
8421.99.90	60% de valor agregado regional
8422.19.00	60% de valor agregado regional
8422.20.00	60% de valor agregado regional
8422.30.10	60% de valor agregado regional
8422.30.21	60% de valor agregado regional
8422.30.22	60% de valor agregado regional
8422.30.29	60% de valor agregado regional
8422.30.30	60% de valor agregado regional
8422.40.10	60% de valor agregado regional
8422.40.20	60% de valor agregado regional
8422.40.90	60% de valor agregado regional
8422.90.90	60% de valor agregado regional
8423.20.00	60% de valor agregado regional
8423.30.11	60% de valor agregado regional
8423.30.19	60% de valor agregado regional
8423.30.90	60% de valor agregado regional
8423.81.10	60% de valor agregado regional
8423.81.90	60% de valor agregado regional
8423.82.00	60% de valor agregado regional
8423.89.00	60% de valor agregado regional
8423.90.29	60% de valor agregado regional
8424.20.00	60% de valor agregado regional
8424.30.10	60% de valor agregado regional
8424.30.20	60% de valor agregado regional
8424.30.30	60% de valor agregado regional
8424.30.90	60% de valor agregado regional
8424.81.19	60% de valor agregado regional
8424.81.21	60% de valor agregado regional
8424.81.29	60% de valor agregado regional
8424.81.90	60% de valor agregado regional
8424.89.00	60% de valor agregado regional
8424.90.90	60% de valor agregado regional
8425.11.00	60% de valor agregado regional
8425.19.90	60% de valor agregado regional
8425.20.00	60% de valor agregado regional
8425.31.10	60% de valor agregado regional
8425.31.90	60% de valor agregado regional
8425.39.10	60% de valor agregado regional
8425.39.90	60% de valor agregado regional

8425.41.00	60% de valor agregado regional
8425.49.90	60% de valor agregado regional
8426.11.00	60% de valor agregado regional
8426.12.00	60% de valor agregado regional
8426.19.00	60% de valor agregado regional
8426.20.00	60% de valor agregado regional
8426.30.00	60% de valor agregado regional
8426.41.00	60% de valor agregado regional
8426.49.00	60% de valor agregado regional
8426.91.00	60% de valor agregado regional
8426.99.00	60% de valor agregado regional
8427.10.11	60% de valor agregado regional
8427.10.19	60% de valor agregado regional
8427.10.90	60% de valor agregado regional
8427.20.10	60% de valor agregado regional
8427.20.90	60% de valor agregado regional
8427.90.00	60% de valor agregado regional
8428.10.00	60% de valor agregado regional
8428.20.10	60% de valor agregado regional
8428.20.90	60% de valor agregado regional
8428.31.00	60% de valor agregado regional
8428.32.00	60% de valor agregado regional
8428.33.00	60% de valor agregado regional
8428.39.10	60% de valor agregado regional
8428.39.20	60% de valor agregado regional
8428.39.30	60% de valor agregado regional
8428.39.90	60% de valor agregado regional
8428.40.00	60% de valor agregado regional
8428.50.00	60% de valor agregado regional
8428.60.00	60% de valor agregado regional
8428.90.10	60% de valor agregado regional
8428.90.20	60% de valor agregado regional
8428.90.30	60% de valor agregado regional
8428.90.90	60% de valor agregado regional
8429.11.10	60% de valor agregado regional
8429.11.90	60% de valor agregado regional
8429.19.10	60% de valor agregado regional
8429.19.90	60% de valor agregado regional
8429.20.10	60% de valor agregado regional
8429.20.90	60% de valor agregado regional
8429.30.00	60% de valor agregado regional
8429.40.00	60% de valor agregado regional
8429.51.11	60% de valor agregado regional
8429.51.19	60% de valor agregado regional
8429.51.21	60% de valor agregado regional
8429.51.29	60% de valor agregado regional
8429.51.90	60% de valor agregado regional
8429.52.10	60% de valor agregado regional
8429.52.90	60% de valor agregado regional
8429.59.00	60% de valor agregado regional
8430.10.00	60% de valor agregado regional
8430.20.00	60% de valor agregado regional
8430.31.10	60% de valor agregado regional
8430.31.90	60% de valor agregado regional

8430.39.10	60% de valor agregado regional
8430.39.90	60% de valor agregado regional
8430.41.10	60% de valor agregado regional
8430.41.20	60% de valor agregado regional
8430.41.30	60% de valor agregado regional
8430.41.90	60% de valor agregado regional
8430.49.10	60% de valor agregado regional
8430.49.20	60% de valor agregado regional
8430.49.90	60% de valor agregado regional
8430.50.00	60% de valor agregado regional
8430.61.00	60% de valor agregado regional
8430.69.11	60% de valor agregado regional
8430.69.19	60% de valor agregado regional
8430.69.90	60% de valor agregado regional
8431.10.90	60% de valor agregado regional
8431.20.11	60% de valor agregado regional
8431.20.19	60% de valor agregado regional
8431.20.90	60% de valor agregado regional
8431.31.10	60% de valor agregado regional
8431.31.90	60% de valor agregado regional
8431.39.00	60% de valor agregado regional
8431.41.00	60% de valor agregado regional
8431.42.00	60% de valor agregado regional
8431.43.10	60% de valor agregado regional
8431.43.90	60% de valor agregado regional
8431.49.10	60% de valor agregado regional
8431.49.20	60% de valor agregado regional
8432.10.00	60% de valor agregado regional
8432.21.00	60% de valor agregado regional
8432.29.00	60% de valor agregado regional
8432.30.10	60% de valor agregado regional
8432.30.90	60% de valor agregado regional
8432.40.00	60% de valor agregado regional
8432.80.00	60% de valor agregado regional
8432.90.00	60% de valor agregado regional
8433.20.10	60% de valor agregado regional
8433.20.90	60% de valor agregado regional
8433.30.00	60% de valor agregado regional
8433.40.00	60% de valor agregado regional
8433.51.00	60% de valor agregado regional
8433.52.00	60% de valor agregado regional
8433.53.00	60% de valor agregado regional
8433.59.11	60% de valor agregado regional
8433.59.19	60% de valor agregado regional
8433.59.90	60% de valor agregado regional
8433.60.10	60% de valor agregado regional
8433.60.90	60% de valor agregado regional
8433.90.90	60% de valor agregado regional
8434.10.00	60% de valor agregado regional
8434.20.10	60% de valor agregado regional
8434.20.90	60% de valor agregado regional
8434.90.00	60% de valor agregado regional
8435.10.00	60% de valor agregado regional
8435.90.00	60% de valor agregado regional

8436.10.00	60% de valor agregado regional
8436.21.00	60% de valor agregado regional
8436.29.00	60% de valor agregado regional
8436.80.00	60% de valor agregado regional
8436.91.00	60% de valor agregado regional
8436.99.00	60% de valor agregado regional
8437.10.00	60% de valor agregado regional
8437.80.10	60% de valor agregado regional
8437.80.90	60% de valor agregado regional
8437.90.00	60% de valor agregado regional
8438.10.00	60% de valor agregado regional
8438.20.10	60% de valor agregado regional
8438.20.90	60% de valor agregado regional
8438.30.00	60% de valor agregado regional
8438.40.00	60% de valor agregado regional
8438.50.00	60% de valor agregado regional
8438.60.00	60% de valor agregado regional
8438.80.10	60% de valor agregado regional
8438.80.20	60% de valor agregado regional
8438.80.90	60% de valor agregado regional
8438.90.00	60% de valor agregado regional
8439.10.10	60% de valor agregado regional
8439.10.20	60% de valor agregado regional
8439.10.30	60% de valor agregado regional
8439.10.90	60% de valor agregado regional
8439.20.00	60% de valor agregado regional
8439.30.10	60% de valor agregado regional
8439.30.20	60% de valor agregado regional
8439.30.30	60% de valor agregado regional
8439.30.90	60% de valor agregado regional
8439.91.00	60% de valor agregado regional
8439.99.00	60% de valor agregado regional
8440.10.11	60% de valor agregado regional
8440.10.19	60% de valor agregado regional
8440.10.90	60% de valor agregado regional
8440.90.00	60% de valor agregado regional
8441.10.10	60% de valor agregado regional
8441.10.90	60% de valor agregado regional
8441.20.00	60% de valor agregado regional
8441.30.10	60% de valor agregado regional
8441.30.90	60% de valor agregado regional
8441.40.00	60% de valor agregado regional
8441.80.00	60% de valor agregado regional
8441.90.00	60% de valor agregado regional
8442.10.00	60% de valor agregado regional
8442.20.00	60% de valor agregado regional
8442.30.00	60% de valor agregado regional
8442.40.10	60% de valor agregado regional
8442.40.20	60% de valor agregado regional
8442.40.30	60% de valor agregado regional
8442.50.00	60% de valor agregado regional
8443.11.10	60% de valor agregado regional
8443.11.90	60% de valor agregado regional
8443.12.00	60% de valor agregado regional

8443.19.10	60% de valor agregado regional
8443.19.90	60% de valor agregado regional
8443.21.00	60% de valor agregado regional
8443.29.00	60% de valor agregado regional
8443.30.00	60% de valor agregado regional
8443.40.10	60% de valor agregado regional
8443.40.90	60% de valor agregado regional
8443.51.00	60% de valor agregado regional
8443.59.10	60% de valor agregado regional
8443.59.90	60% de valor agregado regional
8443.60.10	60% de valor agregado regional
8443.60.20	60% de valor agregado regional
8443.60.90	60% de valor agregado regional
8443.90.10	60% de valor agregado regional
8443.90.90	60% de valor agregado regional
8444.00.10	60% de valor agregado regional
8444.00.20	60% de valor agregado regional
8444.00.90	60% de valor agregado regional
8445.11.10	60% de valor agregado regional
8445.11.20	60% de valor agregado regional
8445.11.90	60% de valor agregado regional
8445.12.00	60% de valor agregado regional
8445.13.00	60% de valor agregado regional
8445.19.10	60% de valor agregado regional
8445.19.21	60% de valor agregado regional
8445.19.22	60% de valor agregado regional
8445.19.23	60% de valor agregado regional
8445.19.24	60% de valor agregado regional
8445.19.25	60% de valor agregado regional
8445.19.26	60% de valor agregado regional
8445.19.27	60% de valor agregado regional
8445.19.29	60% de valor agregado regional
8445.20.10	60% de valor agregado regional
8445.20.20	60% de valor agregado regional
8445.20.30	60% de valor agregado regional
8445.20.40	60% de valor agregado regional
8445.20.70	60% de valor agregado regional
8445.20.80	60% de valor agregado regional
8445.20.90	60% de valor agregado regional
8445.30.10	60% de valor agregado regional
8445.30.90	60% de valor agregado regional
8445.40.11	60% de valor agregado regional
8445.40.12	60% de valor agregado regional
8445.40.18	60% de valor agregado regional
8445.40.19	60% de valor agregado regional
8445.40.21	60% de valor agregado regional
8445.40.29	60% de valor agregado regional
8445.40.31	60% de valor agregado regional
8445.40.39	60% de valor agregado regional
8445.40.40	60% de valor agregado regional
8445.40.90	60% de valor agregado regional
8445.90.10	60% de valor agregado regional
8445.90.20	60% de valor agregado regional
8445.90.30	60% de valor agregado regional

8445.90.40	60% de valor agregado regional
8445.90.90	60% de valor agregado regional
8446.10.10	60% de valor agregado regional
8446.10.90	60% de valor agregado regional
8446.21.00	60% de valor agregado regional
8446.29.00	60% de valor agregado regional
8446.30.10	60% de valor agregado regional
8446.30.20	60% de valor agregado regional
8446.30.30	60% de valor agregado regional
8446.30.40	60% de valor agregado regional
8446.30.90	60% de valor agregado regional
8447.11.00	60% de valor agregado regional
8447.12.00	60% de valor agregado regional
8447.20.21	60% de valor agregado regional
8447.20.29	60% de valor agregado regional
8447.20.30	60% de valor agregado regional
8447.90.10	60% de valor agregado regional
8447.90.20	60% de valor agregado regional
8447.90.90	60% de valor agregado regional
8448.11.10	60% de valor agregado regional
8448.11.20	60% de valor agregado regional
8448.11.90	60% de valor agregado regional
8448.19.00	60% de valor agregado regional
8448.20.10	60% de valor agregado regional
8448.20.20	60% de valor agregado regional
8448.20.30	60% de valor agregado regional
8448.20.90	60% de valor agregado regional
8448.31.00	60% de valor agregado regional
8448.32.11	60% de valor agregado regional
8448.32.19	60% de valor agregado regional
8448.32.20	60% de valor agregado regional
8448.32.30	60% de valor agregado regional
8448.32.40	60% de valor agregado regional
8448.32.50	60% de valor agregado regional
8448.32.90	60% de valor agregado regional
8448.33.10	60% de valor agregado regional
8448.33.90	60% de valor agregado regional
8448.39.11	60% de valor agregado regional
8448.39.12	60% de valor agregado regional
8448.39.17	60% de valor agregado regional
8448.39.19	60% de valor agregado regional
8448.39.21	60% de valor agregado regional
8448.39.22	60% de valor agregado regional
8448.39.23	60% de valor agregado regional
8448.39.29	60% de valor agregado regional
8448.39.91	60% de valor agregado regional
8448.39.92	60% de valor agregado regional
8448.39.99	60% de valor agregado regional
8448.41.00	60% de valor agregado regional
8448.42.00	60% de valor agregado regional
8448.49.10	60% de valor agregado regional
8448.49.20	60% de valor agregado regional
8448.49.90	60% de valor agregado regional
8448.51.00	60% de valor agregado regional



8448.59.10	60% de valor agregado regional
8448.59.22	60% de valor agregado regional
8448.59.29	60% de valor agregado regional
8448.59.30	60% de valor agregado regional
8448.59.40	60% de valor agregado regional
8448.59.90	60% de valor agregado regional
8449.00.10	60% de valor agregado regional
8449.00.20	60% de valor agregado regional
8449.00.80	60% de valor agregado regional
8449.00.91	60% de valor agregado regional
8449.00.99	60% de valor agregado regional
8450.20.10	60% de valor agregado regional
8450.20.90	60% de valor agregado regional
8450.90.10	60% de valor agregado regional
8451.10.00	60% de valor agregado regional
8451.29.00	60% de valor agregado regional
8451.30.10	60% de valor agregado regional
8451.30.99	60% de valor agregado regional
8451.40.10	60% de valor agregado regional
8451.40.21	60% de valor agregado regional
8451.40.29	60% de valor agregado regional
8451.40.90	60% de valor agregado regional
8451.50.10	60% de valor agregado regional
8451.50.20	60% de valor agregado regional
8451.50.90	60% de valor agregado regional
8451.80.00	60% de valor agregado regional
8451.90.90	60% de valor agregado regional
8452.21.10	60% de valor agregado regional
8452.21.20	60% de valor agregado regional
8452.21.90	60% de valor agregado regional
8452.29.10	60% de valor agregado regional
8452.29.21	60% de valor agregado regional
8452.29.22	60% de valor agregado regional
8452.29.23	60% de valor agregado regional
8452.29.29	60% de valor agregado regional
8452.29.90	60% de valor agregado regional
8452.30.00	60% de valor agregado regional
8452.90.91	60% de valor agregado regional
8452.90.92	60% de valor agregado regional
8452.90.93	60% de valor agregado regional
8452.90.99	60% de valor agregado regional
8453.10.10	60% de valor agregado regional
8453.10.90	60% de valor agregado regional
8453.20.00	60% de valor agregado regional
8453.80.00	60% de valor agregado regional
8453.90.00	60% de valor agregado regional
8454.10.00	60% de valor agregado regional
8454.20.10	60% de valor agregado regional
8454.20.90	60% de valor agregado regional
8454.30.10	60% de valor agregado regional
8454.30.20	60% de valor agregado regional
8454.30.90	60% de valor agregado regional
8454.90.10	60% de valor agregado regional
8454.90.90	60% de valor agregado regional

8455.10.00	60% de valor agregado regional
8455.21.10	60% de valor agregado regional
8455.21.90	60% de valor agregado regional
8455.22.10	60% de valor agregado regional
8455.22.90	60% de valor agregado regional
8455.30.10	60% de valor agregado regional
8455.30.90	60% de valor agregado regional
8455.90.00	60% de valor agregado regional
8456.10.11	60% de valor agregado regional
8456.10.19	60% de valor agregado regional
8456.10.90	60% de valor agregado regional
8456.20.10	60% de valor agregado regional
8456.20.90	60% de valor agregado regional
8456.30.11	60% de valor agregado regional
8456.30.19	60% de valor agregado regional
8456.30.90	60% de valor agregado regional
8456.91.00	60% de valor agregado regional
8456.99.00	60% de valor agregado regional
8457.10.00	60% de valor agregado regional
8457.20.10	60% de valor agregado regional
8457.20.90	60% de valor agregado regional
8457.30.10	60% de valor agregado regional
8457.30.90	60% de valor agregado regional
8458.11.10	60% de valor agregado regional
8458.11.90	60% de valor agregado regional
8458.19.10	60% de valor agregado regional
8458.19.90	60% de valor agregado regional
8458.91.00	60% de valor agregado regional
8458.99.00	60% de valor agregado regional
8459.10.00	60% de valor agregado regional
8459.21.10	60% de valor agregado regional
8459.21.91	60% de valor agregado regional
8459.21.99	60% de valor agregado regional
8459.29.00	60% de valor agregado regional
8459.31.00	60% de valor agregado regional
8459.39.00	60% de valor agregado regional
8459.40.00	60% de valor agregado regional
8459.51.00	60% de valor agregado regional
8459.59.00	60% de valor agregado regional
8459.61.00	60% de valor agregado regional
8459.69.00	60% de valor agregado regional
8459.70.00	60% de valor agregado regional
8460.11.00	60% de valor agregado regional
8460.19.00	60% de valor agregado regional
8460.21.00	60% de valor agregado regional
8460.29.00	60% de valor agregado regional
8460.31.00	60% de valor agregado regional
8460.39.00	60% de valor agregado regional
8460.40.11	60% de valor agregado regional
8460.40.19	60% de valor agregado regional
8460.40.91	60% de valor agregado regional
8460.40.99	60% de valor agregado regional
8460.90.10	60% de valor agregado regional
8460.90.90	60% de valor agregado regional

8461.20.10	60% de valor agregado regional
8461.20.90	60% de valor agregado regional
8461.30.10	60% de valor agregado regional
8461.30.90	60% de valor agregado regional
8461.40.11	60% de valor agregado regional
8461.40.12	60% de valor agregado regional
8461.40.19	60% de valor agregado regional
8461.40.91	60% de valor agregado regional
8461.40.99	60% de valor agregado regional
8461.50.10	60% de valor agregado regional
8461.50.20	60% de valor agregado regional
8461.50.90	60% de valor agregado regional
8461.90.10	60% de valor agregado regional
8461.90.90	60% de valor agregado regional
8462.10.11	60% de valor agregado regional
8462.10.19	60% de valor agregado regional
8462.10.90	60% de valor agregado regional
8462.21.00	60% de valor agregado regional
8462.29.00	60% de valor agregado regional
8462.31.00	60% de valor agregado regional
8462.39.10	60% de valor agregado regional
8462.39.90	60% de valor agregado regional
8462.41.00	60% de valor agregado regional
8462.49.00	60% de valor agregado regional
8462.91.11	60% de valor agregado regional
8462.91.19	60% de valor agregado regional
8462.91.91	60% de valor agregado regional
8462.91.99	60% de valor agregado regional
8462.99.10	60% de valor agregado regional
8462.99.20	60% de valor agregado regional
8462.99.90	60% de valor agregado regional
8463.10.10	60% de valor agregado regional
8463.10.90	60% de valor agregado regional
8463.20.10	60% de valor agregado regional
8463.20.90	60% de valor agregado regional
8463.30.00	60% de valor agregado regional
8463.90.10	60% de valor agregado regional
8463.90.90	60% de valor agregado regional
8464.10.00	60% de valor agregado regional
8464.20.10	60% de valor agregado regional
8464.20.90	60% de valor agregado regional
8464.90.11	60% de valor agregado regional
8464.90.19	60% de valor agregado regional
8464.90.90	60% de valor agregado regional
8465.10.00	60% de valor agregado regional
8465.91.10	60% de valor agregado regional
8465.91.20	60% de valor agregado regional
8465.91.90	60% de valor agregado regional
8465.92.11	60% de valor agregado regional
8465.92.19	60% de valor agregado regional
8465.92.90	60% de valor agregado regional
8465.93.10	60% de valor agregado regional
8465.93.90	60% de valor agregado regional
8465.94.00	60% de valor agregado regional

8465.95.11	60% de valor agregado regional
8465.95.12	60% de valor agregado regional
8465.95.91	60% de valor agregado regional
8465.95.92	60% de valor agregado regional
8465.96.00	60% de valor agregado regional
8465.99.00	60% de valor agregado regional
8466.10.00	60% de valor agregado regional
8466.20.10	60% de valor agregado regional
8466.20.90	60% de valor agregado regional
8466.30.00	60% de valor agregado regional
8466.91.00	60% de valor agregado regional
8466.92.00	60% de valor agregado regional
8466.93.11	60% de valor agregado regional
8466.93.19	60% de valor agregado regional
8466.93.20	60% de valor agregado regional
8466.93.30	60% de valor agregado regional
8466.93.40	60% de valor agregado regional
8466.93.50	60% de valor agregado regional
8466.93.60	60% de valor agregado regional
8466.94.10	60% de valor agregado regional
8466.94.20	60% de valor agregado regional
8466.94.30	60% de valor agregado regional
8466.94.90	60% de valor agregado regional
8467.11.10	60% de valor agregado regional
8467.11.90	60% de valor agregado regional
8467.19.00	60% de valor agregado regional
8467.29.93	60% de valor agregado regional
8467.81.00	60% de valor agregado regional
8467.89.00	60% de valor agregado regional
8467.91.00	60% de valor agregado regional
8467.92.00	60% de valor agregado regional
8467.99.00	60% de valor agregado regional
8468.20.00	60% de valor agregado regional
8468.80.10	60% de valor agregado regional
8468.80.90	60% de valor agregado regional
8468.90.20	60% de valor agregado regional
8468.90.90	60% de valor agregado regional
8469.11.00	60% de valor agregado regional
8470.50.11	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>

8470.50.19	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8470.50.90	60% de valor agregado regional
8470.90.10	60% de valor agregado regional
8470.90.90	60% de valor agregado regional
8471.30.12	<p>MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memoria, las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las interfaces de comunicación en serie y paralela acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete, placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener el montaje y soldadura de todos sus componentes;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Pantalla ("display") de los ítem 8473.30.91 y 8473.30.92; y 2) Teclado del ítem 8471.60.52. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.30.19	<p>MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memoria, las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las interfaces de comunicación en serie y paralela acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete, placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener el montaje y soldadura de todos sus componentes;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Pantalla ("display") de los ítem 8473.30.91 y 8473.30.92; y 2) Teclado del ítem 8471.60.52. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.30.90	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.41.90	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de</p>

	<p>subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.11	<p>UNIDADES DIGITALES DE PROCESAMIENTO DE PEQUEÑA CAPACIDAD. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementan las funciones de procesamiento y memoria y las siguientes interfases: en serie, paralela, de unidades de discos magnéticos, de teclado y de video, acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener un montaje y soldadura de todos los componentes. En las unidades digitales de procesamiento del tipo "discless", destinadas a interconexión en redes locales, el montaje de la placa que implementa la interfase de red local podrá sustituir el montaje de las placas que implementan las interfases en serie, paralela y de unidades de discos magnéticos;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" e "B" anteriores. No desnaturaliza el cumplimiento del Régimen de Origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.12	<p>UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; c) unidad de control integrada/interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones;</p> <p>B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y</p> <p>C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables.</p> <p>Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM" del ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.</p>
8471.49.13	<p>UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; c) unidad de control integrada/interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones;</p> <p>B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y</p> <p>C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables.</p> <p>Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM" del ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.</p>

8471.49.14	<p>UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MUY GRANDE. - REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen por lo menos 2 (dos) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria c) unidad de control integrada/interfase; d) soporte y diagnóstico de sistemas; e) canal de comunicación, o alternativamente, el montaje de por lo menos 3 (tres) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones;</p> <p>B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y</p> <p>C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables.</p> <p>Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones de mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM", de los ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen también se aplica a las unidades de control de periférico, tales como controladoras de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y a las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.</p>
8471.49.15	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.21	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.22	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>

8471.49.23	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.31	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.35	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.37	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.41	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>



8471.49.43	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.45	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.46	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.48	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.51	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>

8471.49.52	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.53	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.54	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.55	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.56	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>

8471.49.57	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.59	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.62	<p>DISCOS DUROS. - REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes;</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B";</p> <p>D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B", y</p> <p>E. Para la producción de discos magnéticos duros con capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación.</p>
8471.49.63	<p>DISCOS DUROS. - REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes;</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B";</p> <p>D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B", y</p> <p>E. Para la producción de discos magnéticos duros con capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación.</p>
8471.49.65	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.68.	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p>

	<p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.69	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.71	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.73	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.75	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>

8471.49.76	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.91	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.92	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.93	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.49.94	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>

8471.49.95	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.50.10	<p>UNIDADES DIGITALES DE PROCESAMIENTO DE PEQUEÑA CAPACIDAD. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementan las funciones de procesamiento y memoria y las siguientes interfases: en serie, paralela, de unidades de discos magnéticos, de teclado y de video, acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener un montaje y soldadura de todos los componentes.</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" e "B" anteriores. No desnaturaliza el cumplimiento del Régimen de Origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación. En las unidades digitales de procesamiento del tipo "discless", destinadas a interconexión en redes locales, el montaje de la placa que implementa la interfase de red local podrá sustituir el montaje de las placas que implementan las interfases en serie, paralela y de unidades de discos magnéticos;</p>
8471.50.20	<p>UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; c) unidad de control integrada/interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones;</p> <p>B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y</p> <p>C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables.</p> <p>Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM" del ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.</p>

8471.50.30	<p>UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; c) unidad de control integrada/interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones;</p> <p>B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y</p> <p>C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables.</p> <p>Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM" del ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.</p>
8471.50.40	<p>UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MUY GRANDE. - REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen por lo menos 2 (dos) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria c) unidad de control integrada/interfase; d) soporte y diagnóstico de sistemas; e) canal de comunicación, o alternativamente, el montaje de por lo menos 3 (tres) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones;</p> <p>B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y</p> <p>C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables.</p> <p>Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones de mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM", de los ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen también se aplica a las unidades de control de periférico, tales como controladoras de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y a las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.</p>
8471.50.90	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.11	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos</p>

	<p>atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.13	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:  A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;  B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y  C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.  Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.14	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:  A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;  B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y  C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.  Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.19	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:  A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;  B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y  C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.  Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.21	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:  A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;  B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y  C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.  Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.25	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:  A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;  B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y  C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.  Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de</p>



	alimentación.
8471.60.29	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.41	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.49	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.52	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.53	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>

8471.60.59	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.61	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.62	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.71	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.72	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>

8471.60.73	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.74	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.80	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.60.99	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.70.12	<p>DISCOS DUROS. - REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes;</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B";</p> <p>D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B", y</p> <p>E. Para la producción de discos magnéticos duros con capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación.</p>

8471.70.19	<p>DISCOS DUROS. - REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes;</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B"; D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B", y</p> <p>E. Para la producción de discos magnéticos duros con capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación.</p>
8471.70.31	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.70.39	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.70.90	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.80.13	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>

8471.80.19	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.80.90	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.90.11	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.90.12	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.90.13	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>

8471.90.19	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8471.90.90	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8472.10.00	60% de valor agregado regional
8472.20.00	60% de valor agregado regional
8472.30.90	60% de valor agregado regional
8472.90.10	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8472.90.21	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8472.90.29	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido,</p>

	la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
8472.90.30	60% de valor agregado regional
8472.90.59	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
8472.90.90	60% de valor agregado regional
8473.10.10	60% de valor agregado regional
8473.29.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. REQUISITO: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.
8473.29.90	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
8473.30.11	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
8473.30.19	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8473.30.21	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8473.30.24	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8473.30.29	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8473.30.31	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8473.30.39	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8473.30.41	<p>CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS.</p> <p>REQUISITO: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que</p>



	estos no partan de la subpartida 8473.30.
8473.30.42	PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2. - REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso.
8473.30.49	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. REQUISITO: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.
8473.30.99	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
8473.40.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. REQUISITO: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.
8473.40.70	60% de valor agregado regional
8473.40.90	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
8473.50.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. REQUISITO: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.
8473.50.32	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
8473.50.39	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de

	subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
8473.50.50	PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2. - REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso.
8473.50.90	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
8474.10.00	60% de valor agregado regional
8474.20.10	60% de valor agregado regional
8474.20.90	60% de valor agregado regional
8474.31.00	60% de valor agregado regional
8474.32.00	60% de valor agregado regional
8474.39.00	60% de valor agregado regional
8474.80.10	60% de valor agregado regional
8474.80.90	60% de valor agregado regional
8474.90.00	60% de valor agregado regional
8475.10.00	60% de valor agregado regional
8475.21.00	60% de valor agregado regional
8475.29.10	60% de valor agregado regional
8475.29.90	60% de valor agregado regional
8475.90.00	60% de valor agregado regional
8476.21.00	60% de valor agregado regional
8476.29.00	60% de valor agregado regional
8476.81.00	60% de valor agregado regional
8476.89.10	60% de valor agregado regional
8476.89.90	60% de valor agregado regional
8476.90.00	60% de valor agregado regional
8477.10.11	60% de valor agregado regional
8477.10.19	60% de valor agregado regional
8477.10.21	60% de valor agregado regional
8477.10.29	60% de valor agregado regional
8477.10.91	60% de valor agregado regional
8477.10.99	60% de valor agregado regional
8477.20.10	60% de valor agregado regional
8477.20.90	60% de valor agregado regional
8477.30.10	60% de valor agregado regional
8477.30.90	60% de valor agregado regional
8477.40.00	60% de valor agregado regional
8477.51.00	60% de valor agregado regional
8477.59.11	60% de valor agregado regional
8477.59.19	60% de valor agregado regional
8477.59.90	60% de valor agregado regional

8477.80.00	60% de valor agregado regional
8477.90.00	60% de valor agregado regional
8478.10.10	60% de valor agregado regional
8478.10.90	60% de valor agregado regional
8478.90.00	60% de valor agregado regional
8479.10.10	60% de valor agregado regional
8479.10.90	60% de valor agregado regional
8479.20.00	60% de valor agregado regional
8479.30.00	60% de valor agregado regional
8479.40.00	60% de valor agregado regional
8479.50.00	60% de valor agregado regional
8479.60.00	60% de valor agregado regional
8479.81.10	60% de valor agregado regional
8479.81.90	60% de valor agregado regional
8479.82.10	60% de valor agregado regional
8479.82.90	60% de valor agregado regional
8479.89.11	60% de valor agregado regional
8479.89.12	60% de valor agregado regional
8479.89.21	60% de valor agregado regional
8479.89.22	60% de valor agregado regional
8479.89.40	60% de valor agregado regional
8479.89.91	60% de valor agregado regional
8479.89.92	60% de valor agregado regional
8479.89.99	60% de valor agregado regional
8479.90.90	60% de valor agregado regional
8480.10.00	60% de valor agregado regional
8480.20.00	60% de valor agregado regional
8480.30.00	60% de valor agregado regional
8480.41.00	60% de valor agregado regional
8480.49.10	60% de valor agregado regional
8480.49.90	60% de valor agregado regional
8480.50.00	60% de valor agregado regional
8480.60.00	60% de valor agregado regional
8480.71.00	60% de valor agregado regional
8480.79.00	60% de valor agregado regional
8481.10.00	60% de valor agregado regional
8481.20.90	60% de valor agregado regional
8481.30.00	60% de valor agregado regional
8481.40.00	60% de valor agregado regional
8481.80.21	60% de valor agregado regional
8481.80.29	60% de valor agregado regional
8481.80.39	60% de valor agregado regional
8481.80.92	60% de valor agregado regional
8481.80.93	60% de valor agregado regional
8481.80.94	60% de valor agregado regional
8481.80.95	60% de valor agregado regional
8481.80.96	60% de valor agregado regional
8481.80.97	60% de valor agregado regional
8481.80.99	60% de valor agregado regional
8481.90.90	60% de valor agregado regional
8483.10.50	60% de valor agregado regional
8483.40.10	60% de valor agregado regional
8483.40.90	60% de valor agregado regional
8483.60.11	60% de valor agregado regional

8483.60.19	60% de valor agregado regional
8483.60.90	60% de valor agregado regional
8483.90.00	60% de valor agregado regional
8484.20.00	60% de valor agregado regional
8485.10.00	60% de valor agregado regional
8485.90.00	60% de valor agregado regional
8501.33.10	60% de valor agregado regional
8501.33.20	60% de valor agregado regional
8501.34.11	60% de valor agregado regional
8501.34.19	60% de valor agregado regional
8501.34.20	60% de valor agregado regional
8501.40.21	60% de valor agregado regional
8501.40.29	60% de valor agregado regional
8501.51.10	60% de valor agregado regional
8501.51.20	60% de valor agregado regional
8501.51.90	60% de valor agregado regional
8501.52.10	60% de valor agregado regional
8501.52.20	60% de valor agregado regional
8501.52.90	60% de valor agregado regional
8501.53.10	60% de valor agregado regional
8501.53.20	60% de valor agregado regional
8501.53.90	60% de valor agregado regional
8501.61.00	60% de valor agregado regional
8501.62.00	60% de valor agregado regional
8501.63.00	60% de valor agregado regional
8501.64.00	60% de valor agregado regional
8502.11.10	60% de valor agregado regional
8502.11.90	60% de valor agregado regional
8502.12.10	60% de valor agregado regional
8502.12.90	60% de valor agregado regional
8502.13.11	60% de valor agregado regional
8502.13.19	60% de valor agregado regional
8502.13.90	60% de valor agregado regional
8502.20.11	60% de valor agregado regional
8502.20.19	60% de valor agregado regional
8502.20.90	60% de valor agregado regional
8502.31.00	60% de valor agregado regional
8502.39.00	60% de valor agregado regional
8502.40.10	60% de valor agregado regional
8502.40.90	60% de valor agregado regional
8503.00.90	60% de valor agregado regional
8504.21.00	60% de valor agregado regional
8504.22.00	60% de valor agregado regional
8504.23.00	60% de valor agregado regional
8504.33.00	60% de valor agregado regional
8504.34.00	60% de valor agregado regional
8504.40.30.	60% de valor agregado regional
8504.40.50	60% de valor agregado regional
8504.40.90	60% de valor agregado regional
8504.90.30	60% de valor agregado regional
8504.90.40	60% de valor agregado regional
8505.20.10	60% de valor agregado regional
8505.20.90	60% de valor agregado regional
8505.30.00	60% de valor agregado regional

8505.90.80	60% de valor agregado regional
8505.90.90	60% de valor agregado regional
8510.20.00	60% de valor agregado regional
8510.90.90	60% de valor agregado regional
8511.80.30	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
8514.10.10	60% de valor agregado regional
8514.10.90	60% de valor agregado regional
8514.20.11	60% de valor agregado regional
8514.20.19	60% de valor agregado regional
8514.20.20	60% de valor agregado regional
8514.30.11	60% de valor agregado regional
8514.30.19	60% de valor agregado regional
8514.30.21	60% de valor agregado regional
8514.30.29	60% de valor agregado regional
8514.30.90	60% de valor agregado regional
8514.40.00	60% de valor agregado regional
8514.90.00	60% de valor agregado regional
8515.11.00	60% de valor agregado regional
8515.19.00	60% de valor agregado regional
8515.21.00	60% de valor agregado regional
8515.29.00	60% de valor agregado regional
8515.31.00	60% de valor agregado regional
8515.39.00	60% de valor agregado regional
8515.80.10	60% de valor agregado regional
8515.80.90	60% de valor agregado regional
8515.90.00	60% de valor agregado regional
8517.19.20	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8517.21.10	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8517.21.20	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8517.21.30	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8517.21.90	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8517.22.10	<p>REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto;</p> <p>B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y</p> <p>D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p>
8517.22.90	<p>REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto;</p> <p>B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y</p> <p>D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p>
8517.30.11	<p>REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto;</p> <p>B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y</p> <p>D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p>
8517.30.12	<p>REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto;</p> <p>B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y</p> <p>D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p>







8517.50.99	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8517.80.00	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8517.90.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. REQUISITO: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.
8517.90.92	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8517.90.93	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8517.90.94	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8517.90.99	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8520.90.11	60% de valor agregado regional
8521.10.10	60% de valor agregado regional
8521.10.90	60% de valor agregado regional
8521.90.10	60% de valor agregado regional
8525.10.10	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8525.10.29	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8525.10.39	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8525.20.13	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del





	producto final.
8525.20.90	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8525.30.10	60% de valor agregado regional
8525.30.20	60% de valor agregado regional
8525.40.10	60% de valor agregado regional
8526.10.00	60% de valor agregado regional
8526.91.00	60% de valor agregado regional
8527.90.19	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8529.90.12	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. REQUISITO: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.
8529.90.19	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8529.90.30	60% de valor agregado regional
8529.90.40	60% de valor agregado regional
8530.10.90	60% de valor agregado regional
8530.80.90	60% de valor agregado regional
8530.90.00	60% de valor agregado regional
8531.20.00	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
8537.10.11	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.

8537.10.19	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8537.10.20	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8540.20.20	60% de valor agregado regional
8540.50.20	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
8541.10.22	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y</p> <p>F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.</p>
8541.10.29	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y</p> <p>F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.</p>

8541.10.92	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y</p> <p>F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.</p>
8541.10.99	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y</p> <p>F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.</p>
8541.29.20	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y</p> <p>F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.</p>
8541.30.21	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y</p> <p>F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.</p>
8541.30.29	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y</p> <p>F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.</p>
8541.40.16	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y</p> <p>F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.</p>
8541.40.21	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de</p>

	potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.40.22	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.40.26	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.40.31	CELULAS FOTOVOLTAICAS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico referente a etapas de división, texturización y metalización; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; y D. Marcación (identificación);
8541.40.32	CELULAS FOTOVOLTAICAS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico referente a etapas de división, texturización y metalización; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; y D. Marcación (identificación);
8541.50.20	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8542.10.00	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8542.21.21	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.

8542.21.28	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y</p> <p>F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.</p>
8542.21.29	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y</p> <p>F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.</p>
8542.21.91	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y</p> <p>F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.</p>
8542.21.99	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y</p> <p>F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.</p>
8542.29.21	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y</p> <p>F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.</p>
8542.29.29	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y</p> <p>F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.</p>
8542.60.19	<p>COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada;</p> <p>B. Encapsulamiento de la pastilla montada;</p> <p>C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico;</p> <p>D. Marcación (identificación);</p> <p>E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de</p>



	potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8542.60.90	COMPONENTES A PELÍCULA ESPESA O A PELÍCULA FINA - REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico sobre sustrato; B. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; C. Marcación (identificación); y D. Para la producción de circuitos integrados híbridos están exentos de atender los ítem "A", "B" y "C" los componentes semiconductores utilizados como insumos en la producción de los mismos
8543.11.00	60% de valor agregado regional
8543.19.00	60% de valor agregado regional
8543.20.00	60% de valor agregado regional
8543.30.00	60% de valor agregado regional
8543.40.00	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8543.81.00	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8543.89.12	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8543.89.14	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8543.89.15	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8543.89.19	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8543.89.39	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8543.89.91	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8543.89.99	REQUISITO: Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y

	D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8543.90.90	60% de valor agregado regional
8544.70.10	CABLES ÓPTICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas.
8544.70.30	CABLES ÓPTICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas.
8544.70.90	CABLES ÓPTICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas.
8601.10.00	60% de valor agregado regional
8601.20.00	60% de valor agregado regional
8602.10.00	60% de valor agregado regional
8602.90.00	60% de valor agregado regional
8603.10.00	60% de valor agregado regional
8603.90.00	60% de valor agregado regional
8604.00.00	60% de valor agregado regional
8605.00.10	60% de valor agregado regional
8605.00.90	60% de valor agregado regional
8606.10.00	60% de valor agregado regional
8606.20.00	60% de valor agregado regional
8606.30.00	60% de valor agregado regional
8606.91.00	60% de valor agregado regional
8606.92.00	60% de valor agregado regional
8606.99.00	60% de valor agregado regional
8607.11.10	60% de valor agregado regional
8607.11.20	60% de valor agregado regional
8607.12.00	60% de valor agregado regional
8607.19.11	60% de valor agregado regional
8607.19.19	60% de valor agregado regional
8607.19.90	60% de valor agregado regional
8607.21.00	60% de valor agregado regional
8607.29.00	60% de valor agregado regional
8607.30.00	60% de valor agregado regional
8607.91.00	60% de valor agregado regional

8607.99.00	60% de valor agregado regional
8608.00.11	60% de valor agregado regional
8608.00.12	60% de valor agregado regional
8608.00.90	60% de valor agregado regional
8609.00.00	60% de valor agregado regional
8701.10.00	60% de valor agregado regional
8701.30.00	60% de valor agregado regional
8701.90.00	60% de valor agregado regional
8704.10.00	60% de valor agregado regional
8706.00.20	60% de valor agregado regional
8707.90.10	60% de valor agregado regional
8708.29.11	60% de valor agregado regional
8708.29.12	60% de valor agregado regional
8708.29.13	60% de valor agregado regional
8708.29.14	60% de valor agregado regional
8708.29.19	60% de valor agregado regional
8708.31.10	60% de valor agregado regional
8708.40.11	60% de valor agregado regional
8708.40.19	60% de valor agregado regional
8708.50.11	60% de valor agregado regional
8708.50.19	60% de valor agregado regional
8708.60.10	60% de valor agregado regional
8708.70.10	60% de valor agregado regional
8708.94.11	60% de valor agregado regional
8708.94.12	60% de valor agregado regional
8708.94.13	60% de valor agregado regional
8709.11.00	60% de valor agregado regional
8709.19.00	60% de valor agregado regional
8709.90.00	60% de valor agregado regional
8714.99.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
8714.99.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
8716.20.00	60% de valor agregado regional
8802.11.00	60% de valor agregado regional
8802.12.10	60% de valor agregado regional
8802.12.90	60% de valor agregado regional
8802.20.10	60% de valor agregado regional
8802.20.21	60% de valor agregado regional
8802.20.22	60% de valor agregado regional
8802.20.90	60% de valor agregado regional
8802.30.10	60% de valor agregado regional
8802.30.21	60% de valor agregado regional
8802.30.29	60% de valor agregado regional
8802.30.31	60% de valor agregado regional
8802.30.39	60% de valor agregado regional
8802.30.90	60% de valor agregado regional
8802.40.10	60% de valor agregado regional
8802.40.90	60% de valor agregado regional
8802.60.00	60% de valor agregado regional
8803.10.00	60% de valor agregado regional
8803.20.00	60% de valor agregado regional
8803.30.00	60% de valor agregado regional
8803.90.00	60% de valor agregado regional
8805.10.00	60% de valor agregado regional
8805.21.00	60% de valor agregado regional

8805.29.00	60% de valor agregado regional
8901.10.00	60% de valor agregado regional
8901.20.00	60% de valor agregado regional
8901.30.00	60% de valor agregado regional
8901.90.00	60% de valor agregado regional
8902.00.10	60% de valor agregado regional
8902.00.90	60% de valor agregado regional
8904.00.00	60% de valor agregado regional
8905.10.00	60% de valor agregado regional
8905.20.00	60% de valor agregado regional
8905.90.00	60% de valor agregado regional
8906.10.00	60% de valor agregado regional
8906.90.00	60% de valor agregado regional
8907.10.00	60% de valor agregado regional
8907.90.00	60% de valor agregado regional
9001.10.11	FIBRAS ÓPTICAS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico que resulte en la obtención de la preforma; B. Estiramiento de la fibra; C. Test; D. Embalaje; E. Se admitirá la realización de la actividad descrita en el ítem "A" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; y F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos).
9001.10.19	FIBRAS ÓPTICAS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico que resulte en la obtención de la preforma; B. Estiramiento de la fibra; C. Test; D. Embalaje; E. Se admitirá la realización de la actividad descrita en el ítem "A" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; y F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos).
9001.10.20	CABLES ÓPTICOS. REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas.
9002.11.20	60% de valor agregado regional
9005.80.00	60% de valor agregado regional
9005.90.90	60% de valor agregado regional
9006.10.00	60% de valor agregado regional
9006.30.00	60% de valor agregado regional
9007.19.00	60% de valor agregado regional
9007.20.90	60% de valor agregado regional
9007.91.00	60% de valor agregado regional
9007.92.00	60% de valor agregado regional
9008.20.10	60% de valor agregado regional
9008.20.90	60% de valor agregado regional
9009.11.00	60% de valor agregado regional
9009.12.10	60% de valor agregado regional
9009.12.90	60% de valor agregado regional
9009.21.00	60% de valor agregado regional
9009.22.00	60% de valor agregado regional

9009.30.00	60% de valor agregado regional
9009.91.00	60% de valor agregado regional
9009.92.00	60% de valor agregado regional
9009.93.00	60% de valor agregado regional
9009.99.10	60% de valor agregado regional
9009.99.90	60% de valor agregado regional
9010.10.10	60% de valor agregado regional
9010.10.20	60% de valor agregado regional
9010.10.90	60% de valor agregado regional
9010.50.10	60% de valor agregado regional
9010.90.10	60% de valor agregado regional
9011.10.00	60% de valor agregado regional
9011.20.10	60% de valor agregado regional
9011.20.20	60% de valor agregado regional
9011.20.30	60% de valor agregado regional
9011.80.10	60% de valor agregado regional
9011.80.90	60% de valor agregado regional
9011.90.10	60% de valor agregado regional
9011.90.90	60% de valor agregado regional
9012.10.10	60% de valor agregado regional
9012.10.90	60% de valor agregado regional
9012.90.10	60% de valor agregado regional
9012.90.90	60% de valor agregado regional
9013.10.90	60% de valor agregado regional
9013.20.00	60% de valor agregado regional
9013.90.00	60% de valor agregado regional
9014.10.00	60% de valor agregado regional
9014.20.10	60% de valor agregado regional
9014.20.20	60% de valor agregado regional
9014.20.30	60% de valor agregado regional
9014.20.90	60% de valor agregado regional
9014.80.10	60% de valor agregado regional
9014.80.90	60% de valor agregado regional
9014.90.00	60% de valor agregado regional
9015.10.00	60% de valor agregado regional
9015.20.10	60% de valor agregado regional
9015.20.90	60% de valor agregado regional
9015.30.00	60% de valor agregado regional
9015.40.00	60% de valor agregado regional
9015.80.10	60% de valor agregado regional
9015.80.90	60% de valor agregado regional
9015.90.10	60% de valor agregado regional
9015.90.90	60% de valor agregado regional
9016.00.10	60% de valor agregado regional
9016.00.90	60% de valor agregado regional
9017.10.10	60% de valor agregado regional
9017.90.10	60% de valor agregado regional
9018.11.00	60% de valor agregado regional
9018.12.10	60% de valor agregado regional
9018.12.90	60% de valor agregado regional
9018.13.00	60% de valor agregado regional
9018.14.00	60% de valor agregado regional
9018.19.10	60% de valor agregado regional
9018.19.20	60% de valor agregado regional

9018.19.30	60% de valor agregado regional
9018.19.80	60% de valor agregado regional
9018.19.90	60% de valor agregado regional
9018.20.10	60% de valor agregado regional
9018.20.20	60% de valor agregado regional
9018.20.90	60% de valor agregado regional
9018.41.00	60% de valor agregado regional
9018.49.40	60% de valor agregado regional
9018.49.91	60% de valor agregado regional
9018.50.00	60% de valor agregado regional
9018.90.10	60% de valor agregado regional
9018.90.31	60% de valor agregado regional
9018.90.39	60% de valor agregado regional
9018.90.40	60% de valor agregado regional
9018.90.50	60% de valor agregado regional
9018.90.91	60% de valor agregado regional
9018.90.93	60% de valor agregado regional
9018.90.94	60% de valor agregado regional
9019.10.00	60% de valor agregado regional
9019.20.10	60% de valor agregado regional
9019.20.20	60% de valor agregado regional
9019.20.30	60% de valor agregado regional
9019.20.40	60% de valor agregado regional
9019.20.90	60% de valor agregado regional
9022.12.00	60% de valor agregado regional
9022.13.11	60% de valor agregado regional
9022.13.19	60% de valor agregado regional
9022.13.90	60% de valor agregado regional
9022.14.11	60% de valor agregado regional
9022.14.12	60% de valor agregado regional
9022.14.13	60% de valor agregado regional
9022.14.19	60% de valor agregado regional
9022.14.90	60% de valor agregado regional
9022.19.10	60% de valor agregado regional
9022.19.90	60% de valor agregado regional
9022.21.10	60% de valor agregado regional
9022.21.20	60% de valor agregado regional
9022.21.90	60% de valor agregado regional
9022.29.00	60% de valor agregado regional
9022.30.00	60% de valor agregado regional
9022.90.11	60% de valor agregado regional
9022.90.12	60% de valor agregado regional
9022.90.19	60% de valor agregado regional
9022.90.80	60% de valor agregado regional
9022.90.90	60% de valor agregado regional
9024.10.10	60% de valor agregado regional
9024.10.20	60% de valor agregado regional
9024.10.90	60% de valor agregado regional
9024.80.11	60% de valor agregado regional
9024.80.19	60% de valor agregado regional
9024.80.20	60% de valor agregado regional
9024.80.90	60% de valor agregado regional
9024.90.00	60% de valor agregado regional
9026.10.11	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;

	<p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9027.10.00	60% de valor agregado regional
9027.20.11	60% de valor agregado regional
9027.20.12	60% de valor agregado regional
9027.20.19	60% de valor agregado regional
9027.20.20	60% de valor agregado regional
9027.30.11	60% de valor agregado regional
9027.30.19	60% de valor agregado regional
9027.30.20	60% de valor agregado regional
9027.40.00	60% de valor agregado regional
9027.50.10	60% de valor agregado regional
9027.50.20	60% de valor agregado regional
9027.50.30	60% de valor agregado regional
9027.50.40	60% de valor agregado regional
9027.50.90	60% de valor agregado regional
9027.80.11	60% de valor agregado regional
9027.80.12	60% de valor agregado regional
9027.80.13	60% de valor agregado regional
9027.80.14	60% de valor agregado regional
9027.80.20	60% de valor agregado regional
9027.80.30	60% de valor agregado regional
9027.80.90	60% de valor agregado regional
9027.90.10	60% de valor agregado regional
9027.90.91	60% de valor agregado regional
9027.90.93	60% de valor agregado regional
9027.90.99	60% de valor agregado regional
9028.10.11	60% de valor agregado regional
9028.10.19	60% de valor agregado regional
9028.30.11	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9028.30.21	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos</p>

	atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
9028.30.31	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
9029.10.10	60% de valor agregado regional
9030.10.10	60% de valor agregado regional
9030.10.90	60% de valor agregado regional
9030.20.30	60% de valor agregado regional
9030.31.00	60% de valor agregado regional
9030.39.11	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
9030.39.19	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
9030.39.29	60% de valor agregado regional
9030.39.90	60% de valor agregado regional
9030.40.10	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.



9030.40.20	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9030.40.30	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9030.40.90	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9030.82.10	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9030.82.90	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>

9030.83.10	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9030.83.90	60% de valor agregado regional
9030.89.30	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9030.89.40	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9030.89.90	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9030.90.10	60% de valor agregado regional
9030.90.20	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de</p>

	alimentación.
9030.90.30	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9030.90.90	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9031.10.00	60% de valor agregado regional
9031.20.10	60% de valor agregado regional
9031.20.90	60% de valor agregado regional
9031.30.00	60% de valor agregado regional
9031.41.00	60% de valor agregado regional
9031.49.00	60% de valor agregado regional
9031.80.11	60% de valor agregado regional
9031.80.12	60% de valor agregado regional
9031.80.20	60% de valor agregado regional
9031.80.30	60% de valor agregado regional
9031.80.40	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9031.80.50	60% de valor agregado regional
9031.80.60	60% de valor agregado regional
9031.80.90	60% de valor agregado regional
9031.90.10	60% de valor agregado regional
9031.90.90	60% de valor agregado regional
9032.89.11	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:</p> <p>A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;</p> <p>B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y</p> <p>C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.</p> <p>Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y</p>

	8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
9032.89.21	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
9032.89.22	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
9032.89.23	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
9032.89.24	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
9032.89.25	REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos

	<p>atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9032.89.29	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:  A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;  B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y  C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.  Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9032.89.81	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:  A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;  B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y  C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.  Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9032.89.82	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:  A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;  B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y  C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.  Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9032.89.83	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:  A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;  B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y  C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.  Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>
9032.89.84	60% de valor agregado regional
9032.89.89	<p>REQUISITO: Cumplir con el siguiente proceso productivo:  A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso;  B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y  C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores.  Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido,</p>

	la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.
9032.90.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. REQUISITO: Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.
9402.90.10	60% de valor agregado regional
9402.90.20	60% de valor agregado regional
9406.00.10	60% de valor agregado regional
9406.00.92	60% de valor agregado regional